

证券代码：688035

证券简称：德邦科技

公告编号：2023-047

烟台德邦科技股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款 以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金17,690.85万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）向德邦（昆山）材料有限公司（以下简称“昆山德邦”，为公司全资子公司）提供借款以实施募投项目；使用部分募集资金27,018.19万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）向四川德邦新材料有限公司（以下简称“四川德邦”，为公司全资子公司）提供借款以实施募投项目。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意烟台德邦科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1527号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票3,556万股，每股面值1.00元，每股发行价格46.12元。本次公开发行募集资金总额为人民币164,002.72万元，扣除发行费用15,254.40万元（不含增值税），实际募集资金净额为148,748.32万元，已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于2022年9月14日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（永证验字[2022]第210029号）。公司对募集资金采取

了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	投资方向	项目总投资	拟投入募集资金	实施主体
1	高端电子专用材料生产项目	38,733.48	38,733.48	昆山德邦
2	年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目	6,241.99	6,241.99	四川德邦
3	新建研发中心建设项目	17,690.85	17,690.85	昆山德邦
4	新能源及电子信息封装材料建设项目	30,776.20	30,776.20	四川德邦
合计		93,442.52	93,442.52	

备注：以上内容为变更后的募集资金投资项目明细，具体情况详见 2023 年 8 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《烟台德邦科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-037）。

三、公司使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

（一）向全资子公司昆山德邦提供借款

2023 年 4 月 14 日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将募投项目“新建研发中心建设项目”实施主体变更为全资子公司昆山德邦。

为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用人民币 17,690.85 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）的募集资金向昆山德邦提供无息借款，以实施“新建研发中心建设项目”的募投项目。

(二) 向全资子公司四川德邦提供借款

2023年2月15日，公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》，拟使用人民币30,776.20万元超募资金建设新项目“新能源及电子信息封装材料建设项目”，其中投资10,000万元设立全资子公司四川德邦，并以该公司作为实施主体开展新项目。2023年4月14日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将募投项目“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”变更实施主体为四川德邦，并调减募投项目投资总额至6,241.99万元。

为确保募投项目的顺利实施，公司拟合计使用人民币27,018.19万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）的募集资金向四川德邦提供无息借款，以实施“新能源及电子信息封装材料建设项目”和“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”。

以上借款期限为自实际借款之日起至募投项目结束。

四、本次提供借款对象的基本情况

(一) 德邦（昆山）材料有限公司

- 1、统一社会信用代码：91320583MA25A9JD1J
- 2、法定代表人：解海华
- 3、成立时间：2021年3月2日
- 4、注册资本：10,000.00万元
- 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、住所：昆山市千灯镇石浦汶浦东路216号
- 7、经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新型膜材料销售；合成材料销售；密封用填料销售；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品制造；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
- 8、股权结构：公司持有昆山德邦100%的股权。
- 9、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	49,734.45
净资产	10,398.14
项目	2023年1-6月
营业收入	9,502.98
净利润	856.31

(二) 四川德邦新材料有限公司

1、统一社会信用代码：91511422MAC89A6B0K

2、法定代表人：陈田安

3、成立时间：2023年2月16日

4、注册资本：10,000.00万元

5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

6、住所：四川彭山经济开发区百业路3号

7、经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；高性能密封材料销售；表面功能材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有四川德邦100%的股权。

9、最近一年及一期的主要财务数据

单位：万元

项目	2023年6月30日
总资产	644.25

净资产	630.67
项目	2023年1-6月
营业收入	0
净利润	-79.33

五、本次提供借款的目的及对公司的影响

公司使用募集资金向全资子公司昆山德邦和四川德邦提供无息借款，有利于募投项目的顺利实施，募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

六、本次提供借款后募集资金的使用和管理

为确保募集资金使用安全，授权公司管理层全权办理全资子公司昆山德邦和四川德邦新增设立募集资金专项账户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署相关监管协议等相关事宜。该等募集资金专户仅分别用于“新建研发中心建设项目”和“年产35吨半导体电子封装材料建设项目”、“高新能源及电子信息封装材料建设项目”的存储和使用，不得用作其他用途。公司及全资子公司昆山德邦和四川德邦将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。

七、本次提供借款的审议程序

公司于2023年9月28日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》。同意公司拟使用人民币 17,690.85 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）的募集资金向昆山德邦提供无息借款，以实施公司募集资金投资项目“新建研发中心建设项目”；使用部分超募资金 27,018.19 万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额为准）向四川德邦提供借款以实施募投项目“新能源及电子信息封装材料建设项目”和“年产 35 吨半导体电子封装材料建设项目”。

独立董事发表了同意的独立意见。

上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

八、专项意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次使用部分募集资金向昆山德邦和四川德邦提供无息借款以实施募投项目，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

综上，公司独立董事同意公司本次使用募集资金向昆山德邦和四川德邦提供无息借款以实施募投项目的事项。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次使用部分募集资金向昆山德邦和四川德邦提供无息借款以实施募投项目，系基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。

综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的相关事项已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的决策程序，且系基于募投项目建

设的需要，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司的募集资金管理制度。

综上，保荐机构对于公司使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目相关事项无异议。

特此公告。

烟台德邦科技股份有限公司

董事会

2023年9月29日